



## Doublage collé- 1x Placotherm®+ BA 13 Marine 4.7 - 13+100- 4m- lambda 0,032- R 4,7 m2.k/w- Support Brique isolante

### Description

Les complexes de doublage thermique de la gamme Placotherm®+ se présentent sous forme de panneaux. Ils sont constitués de plaques de plâtre Placo® collées sur un panneau isolant en mousse polyuréthane (PUR) de conductivité thermique = 0,022 W/m.K. Cette solution est constituée du complexe de doublage Placotherm®+ Marine à bords amincis pour une isolation thermique renforcée à destinations des pièces humides. Ce complexe a une réaction au feu B-s1, d0, une conductivité thermique de 22 mW/m.K et une résistance thermique de 4,70 m<sup>2</sup>.K/W.

### Domaines d'emploi

Les complexes de doublage thermique de la gamme Placotherm® + renforcent (jusqu'à R = 7,45) l'isolation thermique des parois auxquelles ils sont associés et sont adaptés à tous les types de constructions : bâtiments d'habitation, établissements recevant du public (ERP), locaux industriels ou commerciaux, en neuf comme en rénovation. Ils conviennent particulièrement aux projets nécessitant une faible emprise au sol des doublages.

### Performances

Type de solution	Type	Placotherm®+
<b>Parement</b>		1x Placotherm®+ BA 13 Marine 4.7 - 13+100
<b>Isolation</b>	<b>Type d'isolant</b>	PUR
	<b>Épaisseur d'isolant</b>	100 mm
	<b>Type de mur support</b>	Brique
	<b>Résistance thermique du support</b>	1,3 m <sup>2</sup> .K/W
	<b>Résistance thermique de l'isolant</b>	4,7 m <sup>2</sup> .K/W
<b>Ossature</b>	<b>Coefficient Up</b>	0,16
	<b>Hauteur limite</b>	4,00 m
	<b>Épaisseur totale</b>	113 mm
<b>Tapée de menuiserie</b>		130 mm
<b>Perméance</b>		P3
<b>Résistance aux chocs</b>		120 J

### Justificatifs

DTA/DTU :

DTU 25.42

## Notes

---

Note générale: Hauteur limite ERP = 4m dalle à dalle Reprise obligatoire entre panneaux au-delà de 3,6m Hors ERP, Pas de limite de hauteur.

Note isolation acoustique:  $\Delta (Rw+C) (dB) < 0$

Note support: Le support sera de type Brique isolante 20cm.

Estimation Placo® sur bases règles ThU 2012.